

第40回エレクトロニクス実装学会春季講演大会 暫定プログラム (法人名にて掲載) ※変更する場合もございます※

3月10日(火)				
会場	A会場 (3階第3会議室)	B会場 (3階第1会議室)	C会場 (3階第2会議室)	D会場 (3階第4会議室)
セッション	回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術1 座長:大島 心平 (小山工業高等専門学校)	材料技術1 座長:大久保 利一 (サーキットネットワーク)	3D・チップレット技術1 座長:福島 宣史 (東北大学)	生成AI 実装技術1 座長:中上 京治 (ダイヤゼブラ)
10:00	10A1-1 (0020) タイル状めっき技術を用いたガラス基板上への平面型25GHz帯パッド(スフィラ)の実装 石田 涼馬 (九州大学)	10B1-1 (0026) 半導体パッケージ内に形成される異種樹脂界面の安定化プロセス 長野 杜春 (リネオセミコンダクタリレーション)	10C1-1 (0003) TSV形成プロセスにおけるSi Deep RIEのマイクロデング効果 小島 龍人 (コナテックジャパン)	10D1-1 (0067) ジェン/AIアーキテクチャ制作支援のための進化アルゴリズムに基づく背景生成手法 程 澤宇 (群馬大学)
10:15	10A1-2 (0105) シリカ被着高圧地機構造を用いた有極型P/C/D(スフィラ)に関する検討 和泉 虎太郎 (電気通信大学)	10B1-2 (0041) 市場分析から見る異業種動向Low Kw/Low D材料 青木 正光 (日本環境技術推進機構)	10C1-2 (0110) 三次元精密実装に向けた高アスペクト比5um後TSV形成プロセス開発と電気特性評価 園田 康太郎 (熊本大学)	10D1-2 (0081) ジェン/AIアーキテクチャ制作支援のための格納情報を用いたStable Video Diffusionの安定化手法 王 鈞 (群馬大学)
10:30	10A1-3 (0106) 積層構造によるスリットパ線路を用いたカルデサック型フィルタの設計に関する検討 渡辺 詠午 (電気通信大学)	10B1-3 (0042) 銅配線を用いた粒子/粒子ペーストの低温接合 山脇 直也 (太陽光酸)	10C1-3 (0070) Chip on Waferプロセスによる、サブミクロン粒子Bump/Sealを用いたアンダーフィル樹脂使用しないパワートリオデバイス開発 今泉 孝之 (リネオセミコンダクタリレーション)	10D1-3 (0037) ジェン/AIアーキテクチャ制作支援における画像補間のための運動誘導拡散モデルの提案と実装 劉 豐偉 (群馬大学)
10:45	10A1-4 (0075) 多周波無線システム向けのマイクロストリップフレックサの設計 徐 振豪 (電気通信大学)	10B1-4 (0052) 温度サイクルによるタイタチタンはんだ接合部の結晶局所変位化 木村 翔星 (大阪大学)		10D1-4 (0047) 歩行リハビリテーションにおける計測の自動化と予測モデル構築に関する研究 石井 大地 (長野工業高等専門学校)
11:00	休憩 11:00~11:15 (15分)			
	回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術2 座長:松崎 徹 (九州工業大学)	材料技術2 座長:田中 俊平 (日東電工)	3D・チップレット技術2 座長:安田 清和 (大阪大学)	生成AI 実装技術2 座長:中上 京治 (ダイヤゼブラ)
11:15	10A2-1 (0121) 集中定数素子を用いたBPF整合回路の統合設計法 大島 心平 (小山工業高等専門学校)	10B2-1 (0064) 高温接合用途に向けたZnAl共析合金の結晶構造と高温引張特性の関係 高野 晋 (鹿児島大学)	10C2-1 (0057) 水表面張力駆動による自己組織化実装を用いたHBM用ハイブリッド接合界面の解析 佐々木 晃太 (東北大学)	10D2-1 (0055) YOLOによる顔検出を用いた、自動運転のカメラ制御同一のアルゴリズム判定技術と交通誘導制御への実装 孫 志勇 (群馬大学)
11:30	10A2-2 (0027) 多層基板上に積層したスリットパ線路共振器によるQ値向上の検証 藤井 俊輔 (九州大学)	10B2-2 (0113) 動的パルスジェネレーションに基づいたカーボンナノチューブ系導電ペーストのインターコネクション制御 井上 雅博 (群馬大学)	10C2-2 (0115) ハイブリッド接合のためのフッ素ナノ塗料を用いた、ボグワッパ接続と接合性評価 佐藤 遼一 (東北大学)	10D2-2 (0056) YOLOによる顔検出の抽出とFaceNetによる個人認識を組み合わせたリアルタイム個人認識システム 林 秋安 (群馬大学)
11:45	10A2-3 (0127) チップ素子、MSL、SIW構造を用いたトリプレタの設計に関する検討 松木 淳一郎 (電気通信大学)	10B2-2 (0096) 半導体パッケージ回路検査用微細プローブ組立への銀微粒子焼結接合の適用 福島 孝典 (群馬大学)	10C2-3 (0053) SiCN膜の膜質がハイブリッドボンディングに及ぼす影響 中田 涼平 (パナソニックホールディングス)	10D2-3 (0044) YOLOを用いた顔画像によるリアルタイム個人認識の実験評価 于 冰平 (群馬大学)
12:00	10A2-4 (0076) 可変インピーダンス変換器における位相制御電圧のシミュレーションと実測の整合性に関する検討 吉田 健人 (電気通信大学)		10C2-4 (0031) マテリアル・インフォマティクスと分子シミュレーションによる界面強度向上設計 岩崎 富生 (日立製作所)	10D2-4 (0046) 機械学習を用いた航空写真からの人物検出手法の検討 柳澤 陽成 (長野工業高等専門学校)
12:15	昼食 12:15~13:15 (60分)	B会場使用不可 12:00~13:35	昼食 12:15~13:15 (60分)	
セッション	回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術3 座長:川上 雅士 (大阪工業大学)	第27回 有機/無機接合研究委員会 司会:山口 敦史 (パナソニックインダストリー) 10B3-1 10:40~14:20 3Dプリンターを利用した鉄鋼と樹脂の異材接合 田中 努 氏 (大阪産業技術研究所)	サーマルマネジメント&パワーエレクトロニクス実装1 座長:山田 友行 (富山県立大学) 10C3-1 (0007) コンボジット材料の熱伝導に寄与するh-BN二次粒子の熱伝導率評価手法の開発 松川 和幸 (三菱電機) 10C3-2 (0008) 3次元熱抵抗を考慮したTDI法によるSiC/Paワーモジュールのジャンクション・ケース間熱抵抗評価方法構築 鈴木 肇 (新電元工業) 10C3-3 (0068) トポロジ最適化を用いた間接変更形状最適化による低熱抵抗トロンク設計 浅井 勇真 (パナソニックインダストリー) 10C3-4 (0135) 光チャップレットに内蔵されたチップの放熱経路に関する考察 星野 雄基 (NTTデバイスロケステクノロジ) 10C3-5 (0136) 光チャップレットパッケージにおける冷却設計に関する考察 永松 郁朗 (NTTデバイスロケステクノロジ)	生成AI 実装技術3 座長:高橋 修司 (図研) 10D3-1 (0051) 豊みだミニチュアネットワークによるDC/DCコンバータの予知保全を組み込みマシンの実装 TO TUAN ANH (群馬大学) 10D3-2 (0086) Raspberry Piを用いた、プロセスの予知保全装置の実装 リアルタイム形状解析による精度の評価 進 浩 (群馬大学) 10D3-3 (0019) 自動車内蔵用ディスプレイ設計のためのサグモデル構築におけるニューラルネットワーク、LSTM、およびGBoostの精度評価 木村 将也 (群馬大学) 10D3-4 (0128) 自己組織化マップを用いた行動分類手法の検討 原田 創憲 (長野工業高等専門学校) 10D3-5 (0083) プリント基板の電源グラウンドプレーンの近傍電界分布と機械学習の分類技術の考察 奈良 茂夫 (AI&EMC研究所)
13:15	10A3-1 (0025) 8GHz帯 帯域幅UWBシステムアンテナの開発 本田 敬士 (九州大学)			
13:30	10A3-2 (0107) スリットパ線路にコプレーナ線路を用いたフィルタリングフィルタの設計に関する検討 河野 通樹 (電気通信大学)			
13:45	10A3-3 (0022) 反射角制御型メタファスの構造設計と電波放射特性への応用 Haibao Li (九州大学)			
14:00	10A3-4 (0061) 第6世代移動通信システム用7GHz帯通電電磁シールドの検討 佐藤 裕弥 (東京工芸大学)			
14:15	休憩 14:15~14:30 (15分) 回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術4 座長:五百旗頭 健吾 (岡山大学)	10B3-2 14:20~15:00 固体イオン交換法を援用したガラス内嵌析出現象の動的観察および評価 河野 美徳 氏 (千葉大学)	休憩 14:30~14:45 (15分) サーマルマネジメント&パワーエレクトロニクス実装2 座長:西村 秀孝 (富士電機) 10C4-1 (0126) ワンダー・モリフォウ・レーザー周囲加熱法によるDBC絶縁放熱基板の界面熱抵抗測定 田中 浩平 (名古屋大学) 10C4-2 (0134) 絶縁NTCサーミスタによるパワーモジュールの高密度熱特性と信頼性評価 吉田 圭吾 (名古屋大学) 10C4-3 (0116) 計測連携CAEによるパワーモジュールの動的な内部熱特性評価手法の検討 前澤 祐 (先端工学シミュレーション研究所) 10C4-4 (0090) 金薄膜転写により平滑化されたダイヤモンド基板と窒化ガリウムチップの大量常温溶接 後藤 慎太郎 (東北大学) 10C4-5 (0059) ダイヤモンドはんだ接合における亜界面増大の非破壊可視化 林 健二 郎 (理化学研究所)	生成AI 実装技術4 座長:岡 大輔 (DOWA/イテック) 10D4-1 (0066) 交通流シミュレーションによる交通誘導ロケットの信号制御最適化手法の提案 周 甘泉 (群馬大学) 10D4-2 (0058) 物流倉庫自動化のためのデジタルタスクにおける自律走行ロボットへの経路経路決定とカメラ測定の最適化 吳 卓人 (群馬大学) 10D4-3 (0018) Ultra-Wide Band帯域システムにおける受信機配置最適化とKalmanフィルタによる作業軌道位置推定の高精度化 井上 采都 (群馬大学) 10D4-4 (0098) 深層強化学習を用いた自律制御移動ロボットのためのネットワーク構造の検討 大瀧 嗣 (長野工業高等専門学校) 10D4-5 (0131) 変分オートエンコーダを用いたマイクロバリオーム組成データの相関関係の推定 岸 知臣 (長野工業高等専門学校)
14:30	10A4-1 (0023) UHF帯CMOSエネルギーハーベスティング回路の設計 SUN YUCHEN (九州大学)			
14:45	10A4-2 (0021) 地上波放送、LTE、Wi-Fi対応3バンド共用差動型RFFEエネルギーハーベスティング回路の設計と実証 中瀬 海斗 (九州大学)			
15:00	10A4-3 (0073) 整流器のDAC モデルを使用した2MHz絶縁結合共振電力伝送システムのシミュレーション 菊地 秀雄 (群馬大学)	休憩 15:00~15:10 (10分) 第27回 有機/無機接合研究委員会 司会:渡辺 潤 (OIKIネット)		
15:15	10A4-4 (0077) 複数のSDRの同期処理に関する検討 川上 雅士 (大阪工業大学)	10B4-1 15:10~15:50 工ボキ樹脂の硬化反応へのシリカフィラーの影響に関する解析 仲 啓志 氏 (東レリサーチセンター)		
15:30	休憩 15:30~15:45 (15分) 回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術5 座長:室賀 翔 (東北大学)			
15:45	10A5-1 (0120) 電磁界シミュレーションを用いた基板の損失誘電率を推定する近似的手法に関する一検討 松浦 弘樹 (電気通信大学)	10B4-2 15:50~16:30 高信頼性アンダーフィル材開発に向けた内部バズミを用いた寿命評価アプローチ 吉田 拓 氏 (ナミックス)		
16:00	10A5-2 (0033) バイオマス由来材料の適用に向けたプリント配線における高周波伝送特性の評価と信号伝送品質の検証 宮川 幸司 (三菱電機)			
16:15	10A5-3 (0050) DDR4 Fly-by-both方式におけるツイスト型スラグ短絡配線が波形品質に与える影響 清本 信朗 (日立製作所)			
16:30	10A5-4 (0093) 超広帯域双方向吸収コンモードフィルタの設計と波形の測定 成島 幸太 (電気通信大学)			
16:45				

3月11日(水)

会場	A会場 (3階第3会議室)	B会場 (3階第1会議室)	C会場 (3階第2会議室)	D会場 (3階第4会議室)
セッション	マイクログマカトニクス実装技術1 座長:森田 伸友 (産業技術総合研究所)	回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術6 座長:松嶋 徹 (九州工業大学)	光回路実装技術1 座長:竹崎 元人 (白山)	MES2025受賞講演 座長:柏木 行康 (大阪産業技術研究所) MES2025論文委員長
時間				時間
10:00	11A1-1 (0016) 信頼性に優れたタイピングのためのn/銀焼結膜の破壊に及ぼす銅粒子添加の効果 Gallegos Alessandra (京都先端科学大学)	11B1-1 (0049) 箱型ハードウェアの3Dモンモノイズに重畳したノイズの特性解析と低周波ノイズの考察 五百旗頭 健吾 (岡山大学)	11C1-1 (0099) Co-packagedアプリケーション向けのポリマー導波路型デバイス テイクワグのモジュール法による最適化	11D1-1 (0142) [研究奨励賞] 微細な周波数分散モデルを用いた超軽量電磁波吸収体における電磁特性の推定に関する検討
10:15	11A1-2 (0035) Al/Ni 発熱反応におけるミスマッチひずみ駆動湾曲変形とその応用 ATHACHAKONGNIPAT Saranankul (京都先端科学大学)	11B1-2 (0071) 半導体ICのEMIT化手法適用と精度検証 高木 玲那 (東芝デバイス&ストレージ)	11C1-2 (0043) 高環境耐性を有するシングルモードポリマー光導波路の開発 谷内 冬馬 (住友ベークライト)	11D1-2 (0143) [研究奨励賞] ポリマー光導波路の低損失化に向けた形状設計 佐々木 こと (京セラ)
10:30	11A1-3 (0124) QCMを用いた、高感度揮発性脂肪族エーテルのリアルタイム検出の検討 下田 楓大 (東京大学)	11B1-3 (0088) 大電力SoCにおける電源供給ネットワークの電流密度最適化手法/バックリッジ設計最適化のアルゴリズム 高橋 成生 (シノコエレクトロニクス)	11C1-3 (0095) シリコノフォニクスを用いた光電変換デバイス 集積回路の設計 上村 結菜 (京セラ)	11D1-3 (0144) [研究奨励賞] 冷却速度と高温放電がSn-3.0Ag-0.5Cuはんだの組織と硬度に及ぼす影響 村田 夢実 (大阪大学)
10:45	11A1-4 (0103) 不織布を基材とした表面増強ナノ粒子基層を用いたアルベド光検出システムの開発 横谷 拓巳 (信州大学)	11B1-4 (0078) 設計初期段階における給電用ワイヤハーネスを模倣した解析モデルの開発 川上 雅士 (大阪工業大学)	11C1-4 (0111) 空冷条件下における+21dBm×16 チャンネルCWDM ELSPF モジュールの光出力特性 白石 勇希 (古河電気工業)	11D1-4 (0145) [研究奨励賞] 接着剤フリー実装技術による皮膚貼付型温度センサの開発 高桑 聖仁 (東京大学/理学工学研究所)
11:00	休憩 11:00~11:15 (15分)			休憩 11:00~11:15 (15分)
	マイクログマカトニクス実装技術2 座長:竹内 晃 (東北大学)	回路・実装設計技術&高速高周波・電磁特性技術7 座長:若生 直樹 (電磁材料研究所)	光回路実装技術2 座長:木下 遼太 (住友ベークライト)	MES2025受賞講演 (各20分) 座長:柏木 行康 (大阪産業技術研究所)
11:15	11A2-1 (0015) MEMS技術を用いたシリコノ製ペーパーチャンバーの作製 柳澤 直輝 (東京理科大学/産業技術総合研究所)	11B2-1 (0123) 超軽量電磁波吸収体を用いたシールド壁体開口部からの漏洩電磁界抑制効果 室賀 翔 (東北大学)	11C2-1 (0153) [依頼講演] 2025年度光回路実装技術ロードマップの概要 大畠 伸夫 氏 (三菱電機)	11D2-1 (0146) [ベストペーパー賞] 低温Cu-Cu接合用硬化剤 神楽 大軌 (奥野製薬工業)
11:30	11A2-2 (0074) O ₂ プラズマと低温加熱を組み合わせたAuの表面活性化による大気中常温チップ接合 松延 晃生 (九州大学)	11B2-2 (0132) 抄紙プロセスを用いたガラス繊維およびCNT複合電導吸収体の試作と評価 根本 純司 (北越コーポレーション)	11C2-2 (0111) 浸漬冷却システム用シングルモード多芯拡大ビームコネクタの開発 アレクサンダー・ワグネル セザンツァ・フアラ (白山)	11D2-2 (0147) [ベストペーパー賞] 電気アジストによるA5052/C1020の高信頼性接合法の検討 小山 真司 (群馬大学)
11:45	11A2-3 (0091) 活性銅原子層を介したSi/CとCuの常温接合 山内 峻平 (九州大学)	11B2-3 (0118) カーボンナノチューブを用いた超軽量電磁波吸収材料の材料設計手法に関する検討 鈴木 曜 (東北大学)	11C2-2 (0100) 浸漬冷却システム用シングルモード多芯拡大ビームコネクタの開発 アレクサンダー・ワグネル セザンツァ・フアラ (白山)	11D2-3 (0148) [ベストペーパー賞] 銀シードをミニエミタ法によるビルドアップフィルム上への微細銅線形成 村川 聡 (DIC)
12:00	11A2-3 (0140) 表面活性化常温接合により形成されたInP/SiC接合界面 中村 潤平 (九州大学)	11B2-4 (0108) もみ殻炭を複合した電磁ノイズ抑制シートにおけるフィル特性の制御に関する検討 鎌野 瑛斗 (東北大学)	11C2-3 (0138) 超小型シリコノフォニクス光トランシーバの長期油浸冷却環境における動作検証 武藤 隆 (アイオー)	11D2-4 (0149) [ベストペーパー賞] Cu-Si ₃ N ₄ 結晶界面基層の接合界面評価 眞 裕章 (大阪大学)
12:15		11B2-5 (0032) ノイズ抑制シートの測定再現性の改善とグラフトノイズ抑制シートの評価 吉田 信 (シーテックス)	11C2-4 (0150) 石英系光導波路技術で進化する多機能ガラス基板 片倉 聖美 (NTT)	
12:30	昼食/ポスターセッション・企業展示・アカデミック展示 コアエリア 12:30~14:15 (105分)			
	11P3 ポスターセッション 3階ホワイエ (15所属) 3/12 ショートプレゼン			
	A 11P3-01 (0014) 球形透明反射スクリーンを用いた空中映像表示システムMirage：ととの応用			阪本 邦夫 (甲南大学) SP1
	B 11P3-02 (0133) 豚生体を対象とした生体通信ネットワークにおける床面電極がつくる表面電流分布解析			横山 真心 (東京工芸大学) SP2
	C 11P3-03 (0029) アルミ配線多層基板			神山 孝一 (メイコー)
	D 11P3-04 (0085) 無電解めっき用電着フォトレジスト			丸田 博之 (シミス)
	E 11P3-05 (0129) EレキCADを使ったパワーモジュール設計・検証			松澤 浩彦 (図研)
	F 11P3-06 (0013) 先端半導体パッケージ向け厚膜ドライフィルムレジストの開発			岸野 真之 (旭化成)
	G 11P3-07 (0028) レーザ剥離用仮接合剤の開発			内田 一幸 (日鉄ケミカル&マテリアル)
	H 11P3-08 (0034) Sn-37.5mass%Bi合金の超塑性変形に及ぼす複合添加の影響			佐藤 成雄 (群馬工業高等専門学校) SP3
	I 11P3-09 (0045) Sn-Bi合金の超塑性に及ぼすBi濃度と添加元素の影響			明石 七祐 (群馬工業高等専門学校) SP4
	J 11P3-10 (0117) 銅銅層フィルムの銅膜質とガス透過性に関する検討			倉世古 絵美 (東し)
	K 11P3-11 (0006) 半導体/金属界面の接触抵抗の精密計測によるデバイス構造最適化			桂 卓哉 (京都工芸繊維大学) SP5
	L 11P3-12 (0084) Cu/SiO ₂ ハイブリッドボンディングの活性化における紫外線処理と真空プラズマ処理の比較			Wu Kejun (ウソ電機)
	M 11P3-13 (0072) 無電解Co-Wめっきの車載用放熱部品への適用可能性検討			菅原 彩 (愛知鋼鋼)
	N 11P3-14 (0024) アルカリ水溶液を用いたリチウム二次電池の発火無効化装置の開発			佐藤 颯 (東北工業大学) SP6
	O 11P3-15 (0109) 大電力宇宙電気推進の研究開発に供する複数機動作実験設備の構築ー スラスタ並列動作実験ー			藤原 理央 (東京工芸大学) SP7
	11T3 企業展示・アカデミック展示 1階展示室B (26所属) ※3月12日の12Tと同様※			
14:15	11T4-1 表彰式 展示室A 司会:高橋 文博 実行委員長 (拓殖大学) MES2025受賞 ベストペーパー賞: 4件、研究奨励賞: 5件、ポスターアワード: 2件 会長挨拶、組織委員長挨拶、大会事業委員長より学会イベント紹介			
15:00	休憩 15:00~15:15 (15分)			
15:15	11T5-1 (0154) 特別講演① 展示室A 司会:室賀 翔 プログラム委員長 (東北大学)、紹介:森 裕幸 組織委員長 (日本アイビーエム) 「小型用陸実装機SLIMの成果とレトロクロック技術」 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 教授 福田 盛介 氏			
16:15	休憩 16:15~16:30 (15分)			
16:30	11T6-1 (0155) 特別講演② 展示室A 司会:室賀 翔 プログラム委員長 (東北大学)、紹介:森 裕幸 組織委員長 (日本アイビーエム) 「ICチップのセキュリティに向けたパッケージと回路技術の進化」 神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科 教授 永田 真 氏			
17:30	移動 17:30~18:00 (30分)			
18:00	交流会 モータウンバグタッドカフェ八王子 (the b) 司会:西井 佑輔 実行副委員長 (奥野製薬工業) ※定員に達しましたので申し込み締め切りました※			
19:45				

・一般発表: 119件
・特別講演: 2件
・依頼講演: 4件
・受賞講演: 8件
・有機無機: 4件
・チュートリアル: 6件
・ポスター: 15件 (学生SP: 7件)
・技術委員会との紹介: 9件
・企業展示: 26件 (展示: 25社)
・アカデミック展示: 1件

口頭
159件
167件

3月11・12日13:00
コピーサービス 展示室B
コーヒースポンサー
SEKISUI
積水化学工業株式会社

ポスターの投票QRコード
投票期間: 3月11日~14日
ポスター
ポスター・研究の内容、説明、質疑応答の観点から
投票をお願いします
投票: 上位 3所属と1位の選択理由の入力

3月12日(木)						
会場	A会場 (3階第3会議室)		B会場 (3階第1会議室)		C会場 (3階第2会議室)	
セッション	電子部品・実装技術		チュートリアル講演		最先端めっき実装技術	
時間	座長: 甲斐 岳彦 (太陽誘電モバイルテクノロジー)		司会: 八甫谷 明彦 (よこはま高度実装技術コンソーシアム)		座長: 藤波 知之 (EEJA)	
10:00	12A1-1 (0094) Sn-3.0Ag-0.5Cuはんだ接合における高温環境下での金属間化合物の成長挙動調査 村田 夢美 (大阪大学)		12B1-1 (0009) 10:00~10:30 電子回路実装技術の役割、人材と将来		12C1-1 (0062) ガラス基板上への高密度無電解めっきプロセス 有清 恵太 (奥野製薬工業)	
10:15	12A1-2 (0119) 防水性能を有したコーティング剤による電子回路基板信頼性向上 酒井 晃光 (日産自動車)		羽深 等 氏 (横浜国立大学)		12C1-2 (0089) 樹脂およびガラス基板上における銅ナノ粒子をシード層としためっき回路形成技術の開発 有村 英俊 (石原ケミカル)	
10:30	12A1-3 (0004) 結晶構造解析を用いたAI多層回路の超音波接合における条件適正化手法の実験的検討 伊藤 宣司 (東芝/東北大学)		12B1-2 (0010) 10:30~11:15 司会: 羽深 等 (横浜国立大学)		12C1-3 (0) 微細配線対応シード層エッチングプロセス 三田 桓夫 (JCU)	
10:45	12A1-4 (0001) Si深堀加工技術を用いた転写可能なAu粒子パンプ 藤野 晶仁 (田中貴金属工業)		どよりもかなり早いプリント配線板、サブストレイト、インターポスターの配線技術 八甫谷 明彦 氏 (よこはま高度実装技術コンソーシアム)		12C1-4 (0) 亜硫酸銀系めっき皮膜に対する高硬度化の検討 富永 誠市 (日進化成)	
11:00	休憩 11:00~11:15 (15分) ポスター 学生のショートプレゼン (各2分、質疑応答なし) 司会: 木下 遼太 (住友ベークライト)		休憩 11:15~11:30 (15分) チュートリアル講演 司会: 宮代 文夫 (よこはま高度実装技術コンソーシアム)		休憩 11:00~11:15 (15分) 環境調和型実装技術 座長: 坂本 浩捷 (ダイセル)	
11:15	12A2-1 SP1~SP7 ポスター 学生によるショートプレゼン		休憩 11:15~11:30 (15分) チュートリアル講演 司会: 宮代 文夫 (よこはま高度実装技術コンソーシアム)		12C2-1 (0151) 【依頼講演】 Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene sulfide)を配合することによるプリント配線板の難燃性、信号品質の向上 伊藤 大祐 氏 (ダイセル/神戸大学)	
11:30	休憩 11:30~11:45 (15分) 検査技術 座長: 野口 祐智 (三条市立大学)		12B2-1 (0112) 11:30~12:15 電子機器の高度化、応用拡大で半導体・配線板構造が変わる！ 本多 進 氏 (サーキットネットワーク)		12C2-2 (0152) 【依頼講演】 挑戦する企業と進める次世代印刷エレクトロニクス技術開発 今若 直人 氏 (鳥取県産業技術センター)	
11:45	12A3-1 (0101) TDC 組み込み型ワンタリキスの遅延付加経路選択回路の設計 山根 杏太 (徳島大学)		12B2-1 (0112) 11:30~12:15 電子機器の高度化、応用拡大で半導体・配線板構造が変わる！ 本多 進 氏 (サーキットネットワーク)		12C2-2 (0152) 【依頼講演】 挑戦する企業と進める次世代印刷エレクトロニクス技術開発 今若 直人 氏 (鳥取県産業技術センター)	
12:00	12A3-3 (0125) 温度補正オプティカルセンサ型コンパレータを用いるチップ間配線検査容易化設計 大森 陽斗 (徳島大学)		12B2-1 (0112) 11:30~12:15 電子機器の高度化、応用拡大で半導体・配線板構造が変わる！ 本多 進 氏 (サーキットネットワーク)		12C2-3 (0060) LC-MS/MSを用いためっき皮膜中PFAS測定技術の開発 石岡 航太 (島津製作所)	
12:15					12C2-3 (0060) LC-MS/MSを用いためっき皮膜中PFAS測定技術の開発 石岡 航太 (島津製作所)	
12:30	昼食/ポスターセッション・企業展示・アカデミック展示 コアタイム 12:30~13:45 (75分)					
	12P3 ポスターセッション 3階ホワイエ (15所属) ※3月11日の11P3と同様※ 12T3 企業展示・アカデミック展示 1階展示室B (26所属)				⑬ ティー・エイ・エス・ツルメント・ジャパン株式会社 ⑭ MI-6株式会社 ⑮ 株式会社日立ハイテク ⑯ サンエック株式会社 ⑰ サイバネットシステム株式会社 ⑱ 株式会社先導力化学ソリューション研究所 ⑲ JFEテクノサチ株式会社	
	① 奥野製薬工業株式会社 ② 株式会社サワフロンテック ③ 丸文株式会社 ④ 田中貴金属工業株式会社 ⑤ ソニエ・コンタクトソリューションズ株式会社 ⑥ 株式会社電場製作所				⑥ 株式会社サワフロンテック ⑦ 東北大学 半導体エレクトロニクス(HuB) ⑧ 株式会社電気印刷研究所 ⑨ ハニ化成株式会社 ⑩ ケイ・エフ・テクノロジー株式会社 ⑪ 日機製作株式会社	
セッション	技術委員会のご紹介・活動報告 1 司会: 技術調査委員会委員長 齊藤 丈晴 (大阪公立大学)		チュートリアル講演 司会: 宮代 文夫 (よこはま高度実装技術コンソーシアム)		配線板・パッケージ基板・部品内蔵技術1 座長: 佐藤 牧子 (ナミックス)	
時間					座長: 佐藤 牧子 (ナミックス)	
13:45	12A4-1 検査技術委員会 内山 浩志 (ニロー・土山)		12B4-1 (0137) 13:45~14:30 光データ通信のための光実装技術、CPOへの期待 期待 平 洋一 氏 (慶應義塾大学)		12C4-1 (0139) 【依頼講演】 I I E C国際標準規格 積層三次元電子モジュールの評価方法について 小島 智 氏 (コニマイデザインオフィス)	
14:00	12A4-2 ヘルスケアエレクトロニクス研究会 山岸 健人 (東京農工大学)		12B4-1 (0137) 13:45~14:30 光データ通信のための光実装技術、CPOへの期待 期待 平 洋一 氏 (慶應義塾大学)		12C4-2 (0079) 埋め込みキャパシタ基板のグランドリターンパスとSI特性の検討 立岡 正 (三井金属)	
14:15	12A4-3 回路・実装設計技術委員会 越地 福嗣 (東京工芸大学)		12B4-1 (0137) 13:45~14:30 光データ通信のための光実装技術、CPOへの期待 期待 平 洋一 氏 (慶應義塾大学)		12C4-3 (0087) 高電圧化によるリバーシブルの絶縁層性能への影響 安藤 雅俊 (大隅工機製造)	
14:30	12A4-4 材料・装置・環境技術委員会 坂本 浩捷 (ダイセル)		休憩 14:30~14:45 (15分) チュートリアル講演 司会: 本多 進 (サーキットネットワーク)		12C4-3 (0087) 高電圧化によるリバーシブルの絶縁層性能への影響 安藤 雅俊 (大隅工機製造)	
14:45	休憩 14:45~15:00 (15分) 技術委員会のご紹介・活動報告 2 司会: 技術調査委員会委員長 齊藤 丈晴 (大阪公立大学)		12B5-1 (0141) 14:45~15:30 設計に活がすMLCC最新動向 -小型高密度実装技術革新-		休憩 14:45~15:00 (15分) 配線板・パッケージ基板・部品内蔵技術2 座長: 佐藤 牧子 (ナミックス)	
15:00	12A5-1 システムインテグレーション実装技術委員会 堀部 晃徳 (日本アイ・ビー・エム)		武藤 弘樹 氏 (村田製作所)		12D5-1 (0044) MLCC焼成時のプリント配線板に対する炭化層の調査 大畑 正 (日産自動車)	
15:15	12A5-2 部品内蔵技術委員会 加藤 義尚 (福岡大学)		12B5-2 (0054) 15:30~16:15 Chipletはどの進むか?		12D5-2 (0065) TGV ガラスの洗浄性に及ぼす洗浄液の表面張力の影響 西原 弘明 (パーカーコーポレーション)	
15:30	12A5-3 最先端めっき実装研究会 発表者調整中		12B5-2 (0054) 15:30~16:15 Chipletはどの進むか?		12D5-3 (0048) 熱ナノインプリントグラフィによる微細配線形成の熱硬化性樹脂への適用 篠原 隼介 (北海道科学大学)	
15:45	12A5-4 電磁特性技術委員会 室賀 翔 (東北大学)		12B5-2 (0054) 15:30~16:15 Chipletはどの進むか?		12D5-4 (0092) ポリプロピレンを使用した低損失プリント配線板の開発 渡辺 哲史 (岡山県工業技術センター)	
16:00	12A5-5 光回路実装技術(OPT)委員会 木下 遼太 (住友ベークライト)		12B5-2 (0054) 15:30~16:15 Chipletはどの進むか?		12D5-5 (0063) 印刷技術で実現する高品質100GHz帯周波数波送技術 野村 健一 (産業技術総合研究所)	
16:15					12D5-5 (0063) 印刷技術で実現する高品質100GHz帯周波数波送技術 野村 健一 (産業技術総合研究所)	